

澜起科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：澜起科技

证券代码：688008

编号：2026-004

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研   <input type="checkbox"/>分析师会议   <input type="checkbox"/>媒体采访  <input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会   <input type="checkbox"/>新闻发布会   <input type="checkbox"/>路演活动  <input type="checkbox"/>现场参观   <input checked="" type="checkbox"/>其他（券商策略会、电话会议）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>ADIA  Aspex  Alpine  Arrowpoint Investment Partners (Singapore) Pte. Ltd.  Anatole Investment Management Limited  Baron capital  Baillie Gifford  Blackrock  Bank of America Securities  Boyu Capital  Cephei Capital  China Universal AM (HK)  Central Asset Investments And Management Holdings (HK) Limited  China Citic Bank Corporation Limited  CloudAlpha Capital  Dymon Asia Capital (Singapore) Pte. Ltd.  GIC  Goldman Sachs AM  Hel Ved Capital Management Limited  Kings Court  Khazanah Nasional Berhad  Kings Court Capital Pte. Ltd</p>

Keystone Investors
LMR Partners
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Monolith Management Limited
Manulife Group
Millennium Capital
Mirae Asset Securities
First Beijing Investment Limited
Fidelity international
Fidelity Investments
Franklin Templeton Investments
FengHe Fund Management Pte. Ltd
Point 72
Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd
Polymer Capital Management (HK) Limited
Schroders plc
Springs Capital (HongKong) Limited
Seatown Holdings International Pte. Ltd
Temasek Holdings (Private) Limited
Torito Capital Limited
Tairen Capital Limited
Value Partners Group Limited
Wellington Management
WT Asset
Yungi Capital Limited
易方达基金管理有限公司
华夏基金管理有限公司
富国基金管理有限公司
汇添富基金管理有限公司

中欧基金管理有限公司
鹏华基金管理有限公司
中庚基金管理有限公司
中欧瑞博管理有限公司
中银基金管理有限公司
信达澳亚基金管理有限公司
农银汇理基金管理有限公司
创金合信基金管理有限公司
前海华杉基金管理有限公司
华泰保兴基金管理有限公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
博时基金管理有限公司
博道基金管理有限公司
合远基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
安联基金管理有限公司
广发基金管理有限公司
开思基金管理有限公司
招商基金管理有限公司
德邦基金管理有限公司
摩根士丹利基金管理有限公司
方正富邦基金管理有限公司
朱雀基金管理有限公司
泓德基金管理有限公司
海富通基金管理有限公司
诺安基金管理有限公司
诺德基金管理公司
金鹰基金管理有限公司
银华基金管理有限公司

长信基金管理有限公司
长城基金管理有限公司
永赢基金管理有限公司
建信基金管理有限公司
景顺长城基金管理有限公司
宝盈基金管理有限公司
宏利基金管理有限公司
平安基金管理有限公司
中信保诚基金管理有限公司
东方基金管理有限公司
东方阿尔法基金管理有限公司
中邮基金管理有限公司
华商基金管理有限公司
华宝基金管理有限公司
大成基金管理有限公司
国投瑞银基金管理有限公司
泰康资产管理有限公司
阳光资产管理有限公司
华夏久盈资产管理有限公司
新华资产管理有限公司
中国人寿资产管理有限公司
工银资产管理有限公司
财通资产管理有限公司
平安资产管理有限公司
友邦人寿
中国人民养老保险有限责任公司
中国人寿养老保险有限责任公司
建信养老金管理有限责任公司
平安养老保险有限责任公司

太平养老保险有限责任公司
大家资产管理有限公司
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司
华泰资产管理有限公司
百年保险资产管理有限公司
太平资产管理有限公司
广发证券股份有限公司
国融证券股份有限公司
国元证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
银河证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
方正证券股份有限公司
红塔证券股份有限公司
三星证券
中信银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
中再资产管理股份有限公司
中银理财有限责任公司
中颖投资管理有限公司
南土资产管理有限公司
壁仞科技股份有限公司
奥明资产管理有限公司
敦和资产管理有限公司
中金资产管理有限公司
浙商资产管理有限公司
中睿合银投资管理有限公司
彬元资本管理有限公司
混沌投资管理有限公司

聚鸣投资管理有限公司
阳光资产管理有限公司
上海从容投资管理有限公司
上海利幄私募x管理有限公司
六妙星私募基金管理有限公司
宏道投资管理有限公司
上海浦泓投资管理有限公司
海创(上海)私募基金管理有限公司
汉和汉华资本管理有限公司
上海汐泰投资管理有限公司
泉果基金管理有限公司
上海杉树资产管理有限公司
杭银理财有限责任公司
杭州晟维资产管理有限公司
上海彤心雕珑私募基金管理有限公司
德华创业投资有限公司
深圳市恒泽私募证券投资基金管理有限公司
华能贵诚信托有限公司
北京测度科技有限公司
北京紫薇私募基金管理有限公司
浙江益恒投资管理有限公司
上海睿扬投资管理有限公司
深圳市红筹投资有限公司
浙江英睿投资管理有限公司
上海毓盛投资管理有限公司
北京诚旻投资有限公司
上海涡流私募基金管理有限公司
淡水泉(北京)投资管理有限公司
深圳清水源投资管理有限公司

	<p>深圳猎投资本合伙企业(有限合伙)</p> <p>广州市玄元投资管理有限公司(公司)</p> <p>上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)</p> <p>上海瓴仁私募基金管理合伙企业</p> <p>上海白犀私募基金管理有限公司</p> <p>上海趣时资产管理有限公司(公司)</p> <p>远信 (珠海) 私募基金管理有限公司</p> <p>鼎峰资产管理有限公司</p> <p>广州趣丸网络科技有限公司</p> <p>守正基金(香港)</p> <p>复胜资产管理有限公司</p> <p>上海姚泾河私募基金管理有限公司</p> <p>上海保银私募基金管理有限公司</p> <p>泽泉投资管理有限公司</p> <p>2025年度暨2026年第一季度业绩说明会线上投资者</p>
时间	2026年5月12日~5月15日
地点	公司会议室、券商策略会现场，部分通过电话会议形式接待调研。公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会在上证路演中心网站（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）举办。
出席人员	公司董事长兼CEO杨崇和博士、董事兼总经理Stephen Tai先生、独立董事YUHUA CHENG（程玉华）先生、副总经理兼财务负责人苏琳女士、董事会秘书傅晓女士参加业绩说明会；傅晓女士等参加其他投资者交流活动。
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、交流的主要问题及答复</b></p> <p><b>问题1：随着算力和存储快速发展，行业分析认为互连正在逐渐成为AI系统的瓶颈，各种互连芯片的重要性越来越受关注，公司如何推进自身战略目标的实现？</b></p> <p><b>答复：</b>我们认为，在人工智能时代，AI基础设施有三大核心支柱：算力、存力和运力。其中，算力以GPU、ASIC、CPU等芯片为核心载体，存力依托HBM、DRAM、SSD等存储介质，而澜起则专注于第三大支柱——运力。</p> <p>运力类似于数据传输的“高速公路”，连接起芯片间、服务器间、集群间乃至数据中心间的多层次互连与通信。随着AI大模型的快速迭代与规模化部署，</p>

推动数据中心向超高算力、超高带宽、超低延迟方向演进，运力的作用愈发关键。数据中心需要各类高速互连芯片提升各组件间的通信效率，进而全面提升系统的整体效率。在AI系统中，运力正提升至与算力、存力并重的战略高度。

澜起的愿景是成为国际领先的全互连芯片设计公司。我们将从四个方面来推进公司的发展战略。

首先，在产品战略上，我们将继续聚焦研发创新，通过丰富产品矩阵不断拓展业务边界。在内存互连领域，我们将进一步巩固行业领先地位；在PCIe/CXL互连领域，已实现PCIe Retimer和CXL MXC两款产品量产，目前正全力推进PCIe Switch芯片的研发；在以太网和光互连领域，我们计划运用自研、合作或者投资并购等多种方式，推进产品布局。

其次，在人才战略上，作为以人为核心的高科技企业，公司研发技术人员占比超过70%，我们未来仍将坚持以人才为核心，持续吸纳高水平的研发与管理人才，这是支撑公司产品布局与战略落地的核心动力。

第三，我们将继续保持技术和市场的领先地位，除已成为JEDEC董事会成员之外，我们还在PCI-SIG、CXL联盟、UAlink联盟等行业组织里担任重要的成员，积极参与行业产品的标准制定。同时，我们也将携手合作生态伙伴，加速前沿技术和新产品的应用。

最后，我们将积极探寻投资和并购机会，提升公司的外延发展能力。

## **问题2：未来内存互连芯片市场规模增长的驱动因素有哪些？**

**答复：**未来内存互连芯片市场增长的直接驱动因素包括内存模组数量的增长以及内存互连芯片价值量增加。具体体现在以下四个方面：

第一，CPU在AI服务器用量增加将推动内存模组需求增长。根据行业分析，随着AI推理及Agent应用的快速发展，AI工作负载正在从训练端大规模向推理端及智能体迁移，这一转变对系统的逻辑判断、任务调度与实时交互能力提出了更高的要求，使得CPU的通用计算架构价值凸显，在AI系统中的重要性正在加强，因此，AI服务器中CPU与GPU的配置比例预计将持续提升。随着AI服务器中CPU占比的提升，内存模组数量将随之增长；同时，典型AI服务器内单颗CPU配置的内存模组用量，通常是通用服务器的2倍左右。因此，CPU在AI服务器用量增加将推动内存模组需求增长及内存互连芯片市场规模。

第二，CPU支持内存通道数增加将提升搭配内存模组数量。当前主流服务器CPU平台支持的内存通道数为8或12个，新一代CPU支持的内存通道数或将增加

至16个，内存通道数增加意味着每个CPU最多可搭配的内存模组数量将相应增加。考虑到典型的AI服务器通常满插内存模组，因此，CPU内存通道数增加理论上将进一步提升内存模组需求及内存互连芯片市场规模。

第三，CPU多核化趋势将推动MRDIMM的需求。为满足AI、大数据等应用对算力与数据吞吐的迫切需求，服务器CPU的核心数量快速增加，这对内存系统带宽提出了更高的要求。MRDIMM以其带宽更高和更优的综合性能，正在成为产业重要的技术方向。未来随着支持第二代MRDIMM的CPU上市，MRDIMM的渗透率有望进一步提升，从而直接带动MRCD/MDB芯片需求增长。由于MRDIMM中“1颗MRCD+10颗MDB套片”的价值量远高于RDIMM中一颗RCD芯片的价值量，因此，MRDIMM需求增长将有助于内存互连芯片市场进一步扩容。

第四，从长期来看，DDR6内存模组或将需要更多、更复杂的内存互连芯片。JEDEC组织正持续对DDR6内存互连技术以及产品标准进行讨论，主流趋势是：DDR6内存模组将配置数量更多、设计更复杂的内存互连芯片。因此，DDR6内存互连芯片市场规模或将进一步增长。

总结而言，AI从训练向推理迁移，以及Agent等新应用的爆发，对全球内存互连芯片市场扩容具有积极影响。我们凭借在DDR5子代迭代的领先优势，以及对DDR6等前沿技术的率先布局，将持续受益于这一产业趋势。

**问题3： Arm架构的服务器CPU也需要内存接口芯片吗？**

**答复：**内存接口芯片是JEDEC定义的标准化产品，可支持所有符合JEDEC标准的服务器CPU。根据公开资料，多家北美云服务提供商自研的Arm架构CPU，以及Arm公司自研的AGI CPU均支持DDR5内存模组，也需要搭配内存接口芯片。

**问题4： 请问公司的产品和业务基于哪些核心技术，这些技术对公司的产品布局有哪些影响？**

**答复：**我们的核心技术聚焦两大方向，内存接口技术和高速SerDes技术。

其中，内存接口技术作为内存互连产品的底层核心技术，属于高速、非线性数模混合电路领域，技术门槛极高。随着技术迭代，我们逐步掌握了该领域的主导权，不仅奠定了在DDR4和DDR5世代的行业领先地位，更基于技术升级推动行业衍生出MRCD/MDB/CKD芯片等新产品，而澜起作为这些创新产品标准的牵头制定者，我们通过持续技术突破引领行业创新，进一步巩固领先优势。

公司另一项核心技术是高速SerDes技术，它是高速互连芯片领域的关键底层技术，依托这项技术，我们已经成功开发出分别采用32GT/s和64GT/s的PCIe 5.0和6.0 Retimer芯片，目前128GT/s的SerDes技术也在研发中，未来将应用于我们的PCIe 7.0 Retimer芯片。这项技术的重要性体现在以下几点：一方面，它将支撑Retimer芯片未来的持续迭代；另一方面，它也是我们在研PCIe Switch芯片的核心基础技术；同时，我们计划布局的以太网和光互连领域也需要用到SerDes技术，尽管以太网协议和PCIe协议存在差异，但两者在高速互连的底层技术上是相通的。SerDes技术的成功研发，为我们拓展至更广的高速互连领域、完善产品布局，筑牢了技术根基。

**问题5：请问MRDIMM预计什么时候可以规模产业化，这个产品未来上量的推动因素有哪些？公司有哪些竞争优势？**

**答复：**MRDIMM是JEDEC制定的服务器高带宽内存模组标准，主要用于满足CPU多核化趋势下AI和高性能计算应用对内存带宽日益增长的迫切需求。

MRDIMM目前仍处于第二子代产品规模试用阶段，行业预期未来两到三年将从规模应用起步，进入快速爬升阶段，推动其发展因素主要有三点：

第一，从技术演进看，MRDIMM性能持续领先。第二子代MRDIMM的数据传输速率为12800MT/s，相比第一子代产品（支持速率8800MT/s）提升45%，是当前主流第三子代RDIMM（支持速率6400MT/s）的两倍，可有效缓解AI推理等应用场景的内存带宽瓶颈，而第三子代MRDIMM支持速率将达到16000MT/s，再次实现性能跃升。

第二，从产业生态看，CPU支持逐步成熟。预计从2026年下半年至2027年，将有更多的服务器CPU平台支持第二子代MRDIMM。CPU平台的广泛支持是MRDIMM在数据中心规模部署的基础，其产业生态将进一步完善。

第三，从需求驱动看，AI推理与Agent等应用有望为MRDIMM带来结构性、长期的机遇。此类应用会产生海量的KV Cache，对内存带宽提出更高要求。MRDIMM的高带宽特性，能以更优的总体拥有成本满足相关应用的需求。近期，随着RDIMM价格的快速上涨，进一步凸显了MRDIMM的性价比优势，有利于MRDIMM在下游的推广。

因此，随着MRDIMM行业渗透率的提升，MRCD/MDB芯片市场规模也将快速增长。

作为MDB芯片国际标准的牵头制定者，公司引领相关技术的创新并保持行

业领先地位。2025年1月，我们推出了第二子代MRCD/MDB芯片，在最近的两个季度实现出货量显著提升，我们的产品凭借优异的性能和出色的稳定性获得全球主要内存模组厂商的认可，为后续产业放量奠定了基础。此外，我们计划今年完成第三子代MRCD/MDB芯片的工程研发，以持续巩固技术领先地位。

**问题6：公司研发费用的主要有哪些构成？去年和今年一季度的研发投入持续增长，请问如何预期后续研发费用增长趋势？**

**答复：**公司的研发费用主要由于研发技术人员薪酬、工程开发费用、相关工具及许可证费用等构成。2025年公司研发费用为9.15亿元，同比增长近20%；今年一季度，公司研发费用为1.88亿元，同比增长23%。

自公司2019年上市以来，研发费用连续六年保持增长。展望未来，随着公司业务规模的扩大和在研项目的持续推进，研发费用预计将保持合理增长。公司会依据不同项目的技术阶段、市场前景与风险，对研发资源进行合理配置。

**问题7：公司PCIe Retimer以及PCIe Switch芯片市场导入和研发进展情况如何？公司未来期望在PCIe互连领域占据多大的市场份额？**

**答复：**公司的PCIe Retimer芯片基于行业开放标准研发，面向全球市场销售。目前，公司PCIe Retimer芯片的出货以Gen 5产品为主。在国内市场中，依托优异的产品性能和本土服务支持的双重优势，澜起的PCIe Retimer芯片更受客户青睐。展望未来，随着国内外CSP厂商继续加大在AI领域的资本开支，叠加国产算力卡在国内市场的进一步应用，预计PCIe Retimer芯片需求将持续提升。

公司于2025年1月推出PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer芯片并向客户送样，目前正积极配合客户测试验证。由于支持PCIe 6.0的服务器CPU尚未进入规模量产阶段，相关Retimer芯片仍处于产业导入期，行业预期2027年PCIe 6.0 Retimer芯片将进入正式的规模应用阶段。此外，我们于今年1月发布了PCIe 6.x/CXL 3.x 的AEC解决方案。目前我们正在积极推进PCIe 7.0 Retimer芯片的研发，计划今年完成工程样片的流片。

PCIe Switch 芯片是数据中心、AI加速及存储系统的核心互连组件，也是公司在PCIe互连领域拓展产品矩阵、完善互连解决方案能力的关键布局，目前相关研发工作正常推进。

根据行业分析，PCIe互连芯片未来市场规模将持续增长。我们认为，未来市场份额的获取将取决于扎实的技术储备、可靠的产品交付以及准确把握市场导

入时机的能力。对公司而言，关键是持续做好产品的研发和技术迭代。随着PCIe Retimer芯片的代际升级，以及未来PCIe Switch芯片的推出，我们希望凭借核心技术优势及逐步完善的产品组合，在未来的市场竞争中持续提升份额。

**问题8：CXL技术最近一段时间在行业内热度比较高，是不是意味着CXL MXC芯片的大规模商业化也临近了，公司目前相关产品的进展如何，如何展望未来这个市场的竞争情况？**

**答复：**当前，产业界正积极推进CXL技术的落地与商业化，众多CSP厂商正在积极部署相关产品。例如，某头部云厂商推出了基于CXL的数据库专用服务器；某头部服务器厂商发布了集成CXL内存扩展方案的服务器产品。其核心驱动力在于AI推理等场景对海量、低延迟内存的迫切需求，CXL技术能够通过分层存储与池化，有效缓解“内存墙”限制，从而显著降低系统总拥有成本（TCO）。根据某头部云厂商推出的内存池方案，其单个内存池配置16-32颗CXL MXC芯片。

行业分析认为，今年是CXL规模化部署的起点，预计到2027年将进入CXL规模商用的元年。随着支持CXL 3.0的服务器CPU平台量产，更先进的内存池化方案将逐步落地，未来几年CXL在数据中心的渗透率有望快速提升。从客户价值看，一方面，使用传统内存扩容方式成本高昂，叠加近期DRAM涨价，通过CXL进行内存扩展和池化成为高性价比的方案；另一方面，CXL技术可实现对DDR4等早期内存的复用，进一步增强其吸引力。

公司在CXL互连领域的竞争优势主要体现在以下几方面：

1. 技术先发和持续领先。公司于2022年全球首发CXL MXC芯片，并于2025年9月推出CXL 3.1 MXC芯片，目前已向主要客户送样测试，保持行业技术引领地位。

2. 深厚的客户与生态壁垒。近年来，公司与合作伙伴共同推进CXL技术的商用化进程，目前已助力多家服务器厂商及云厂商推出基于澜起MXC芯片的内存扩展和内存池化方案。从研发初期即开展的深度合作，为我们构建了稳固的客户基础和生态优势。

3. 完整的解决方案能力。除了MXC芯片，我们还提供PCIe/CXL Retimer芯片，用于保障高速信号完整性。这为我们构建了从内存控制到高速互连的一站式解决方案能力，增强了市场综合竞争力。

展望未来，随着CXL生态的逐步成熟和技术的广泛普及，MXC芯片市场将迎来广阔的发展空间，公司有望凭借上述优势持续受益于该产业趋势。

**问题9：公司H股上市后，有哪些新的规划，对公司未来发展有哪些机遇和影响？**

**答复：**公司成功在H股上市，构建起“A+H”双资本平台，为我们带来了多维度的发展机遇。

首先，H股上市有助于我们进一步吸引国际顶尖人才，深化全球业务布局，并提升品牌的国际影响力；其次，募集资金将为公司核心技术迭代提供有力支撑，覆盖内存互连、PCIe/CXL互连以及底层SerDes技术方向，并支持我们向以太网及光互连等更广阔的市场进行拓展；再次，部分募集资金将用于战略投资或收购，帮助公司快速获取新技术、进入新市场或整合产业链资源，从而构建更完整的产品与解决方案体系。同时，登陆国际资本市场也让更多海外投资人有机会进一步认识和投资澜起，有利于优化公司的估值体系。

我们将以H股上市为契机，借助国际资本市场的力量，加速技术优势的巩固与全球业务拓展，把握人工智能时代的历史性机遇。

**问题10：一季度公司的毛利率表现特别优秀，想请教下，目前的毛利率水平是否能够维持，或者有进一步提升的空间？**

**答复：**2026年第一季度，公司整体毛利率为69.8%；随着DDR5新子代RCD芯片及互连类芯片新产品（MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXL MXC）收入占比提高，互连类芯片产品线毛利率达到71.5%，较上年同期增加7.0个百分点，较上季度增加3.8个百分点。

公司互连类芯片的产品品类越来越多，同一品类产品也在持续升级迭代，互连类芯片毛利率更多体现了多款产品的综合毛利率水平，与公司当期销售的产品结构相关。展望未来，通过持续的子代迭代和高端新产品的推出，互连类芯片毛利率有望保持在较高水平。

**问题11：请公司介绍下未来在以太网和光互连领域的布局思路？**

**答复：**以太网 PHY Retimer芯片主要用于保障AI服务器与交换机之间高速互连信号的完整性和可靠性。该产品是公司在以太网互连领域正式布局的首款芯片。

公司的战略目标是成为国际领先的全互连芯片设计公司。以太网及光互连作为高速互连领域的核心组成部分，市场空间广阔。我们将从以下几个方面推进在该领域的布局：1. 我们将充分依托在高速互连领域长期积累的技术和生态资

	<p>源，特别是将自主研发的高速SerDes技术从PCIe领域延伸至以太网领域；2. 我们将持续吸引以太网及光互连领域的全球顶尖技术人才加入，组建专业的研发团队，以加速底层技术及产品的研发进程；3. 我们还将通过合作及/或投资等多种方式，循序渐进、稳步推进相关产品布局，以构建公司在该领域的长期竞争力。</p>
<p>是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>